



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **26**

Zeilenanzahl: **2**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Abreißen
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	26
Zeilenanzahl	2
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

### Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung	30 VAC
-----------------	--------

### Sonstige Eigenschaften

Profil des Steckverbinders	Standard
Primäre Produktfarbe	Schwarz

### Kontaktmerkmale

Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.64 mm[.025 in]
	100 – 200 µin

Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Kontaktform	Quadratisch
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.381 µm[15 µin]
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

### Klemmenmerkmale

Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen	.64 mm[.025 in]
Anschlussstift- und Restlänge	3.18 mm[.125 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Lötten

### Montage und Anschlusstechnik

Art der Leiterplattenmontage	Arretierungslötenden
Gegensteckführung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

### Gehäusemerkmale

Raster	2.54 mm[.1 in]
Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast

### Abmessungen

Reihenabstand	2.54 mm[.1 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm[.062 in]

### Verwendungsbedingungen

Gehäusenenntemperatur	Hoch
Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

### Betrieb/Anwendung

Lötverfahrenfunktion	Plattenabstand
Stromkreis Anwendung	Signal

### Industriestandards

Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	120
Verpackungs-Typ	Karton

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Brom-/Chlorgehalt – Br und Cl < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Pin-in-Paste-tauglich bis 260 °C

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Auch serienmäßig | **AMPMODU Headers**



Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(66)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(5)



Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(2)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (6117)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(1)

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:1-1393788-6  
V23079A1005B301



TE Teilnr.:DTM13-12PA-R008  
HDR, 12P, BLK, RA EEC, NI/CU, A

## Dokumente

### Produktzeichnungen

26 MODII HDR DRST B/A 100 W/HD

Englisch

### Datenblätter/ Katalogseiten

AMPMODU Interconnection System

AMPMODU Interconnection System

Englisch